



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、 _____ 殿 に納入する miniSDソケットコネクタ について規定する。

This specification covers the miniSD SOCKET CONNECTOR series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number
ヘッダーアセンブリー Header Assembly	【無鉛】 (Lead Free) 500972-1109
エンボス梱包品 Embossed Package	【無鉛】 (Lead Free) 500972-1107

【3. 定格 RATINGS】

項目 Item	規格 Standard
最大許容電圧 Rated Voltage (MAXIMUM)	10 V
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.5 A
使用温度範囲 Ambient Temperature Range	-25°C ~ +85°C *1
使用湿度範囲 Ambient Humidity Range	95%R.H. MAXIMUM *2
保存温度範囲 Storage Temperature Range	+5°C ~ +35°C
保存湿度範囲 Storage Humidity Range	85%R.H. MAXIMUM *2

*1 : 通電による温度上昇分も含む。 Including terminal temperature rise.

*2 : 結露なきこと。 Storage area is to be free of dew formation.

REV.	C						
SHEET	1~14						
REVISE ON PC ONLY		TITLE:					
C	変更 REVISED J2006-0835 '05/09/13 K.YAMANE		miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE)				製品仕様書
	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
REV.	DESCRIPTION		WRITTEN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: YR/MO/DAY	
	DESIGN CONTROL	STATUS	K.YAMANE	M.YAGI	J.MIYAZAWA	2004/07/14	
DOCUMENT NUMBER						FILE NAME	SHEET
PS-500972-001						PS-500972-001.doc	1 OF 14



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	ダミーカード ^{*1} を嵌合させ、開放電圧20mV以下、短絡電流10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate dummy card, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	100 milliohms MAXIMUM
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	隣接するターミナル間及びターミナル、アース間にDC 500Vを印加し、測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Apply 500V DC between adjacent terminals or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohms MINIMUM
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	隣接するターミナル間及びターミナル、アース間にAC 500V (実効値)を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Apply 500V AC for 1 minute between adjacent terminals and ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown

*1 ダミーカードとは、当社製評価用ノミナルカードを示す
(カード厚1.4mm、カードパット厚1.2mm)。

第6項参照。

The dummy card shows the evaluation nominal card made of our company
(the card thickness 1.4mm, the card pad thickness 1.2mm).

See paragraph 6.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 14	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-500972-001	FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14	SHEET 2 OF 14
---	--------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition		規格 Requirement	
4-2-1	端子、金具保持力 Terminal, Nail Retention Force	毎分25±3mmの速さで端子、金具を軸方向に引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm/minute.		0.98 N MINIMUM / PIN {0.1 kgf MINIMUM / PIN}	
4-2-2	挿入力及び抜去力 Insertion / Withdrawal Force	毎分25±3 mmの速さでダミーカードを押す。 Push the dummy card at the speed rate of 25±3 mm/minute.	カムロック荷重 Lock Force	4.9~13.8 N {0.5~1.4 kgf}	
			カムロック解除荷重 Lock Release Force	4.9~13.8 N {0.5~1.4 kgf} カードが飛び出すこと To discharge the card	
4-2-3	カード無理抜き力 Forced Withdrawal	ダミーカードをカード嵌合状態から毎分25±3mmの速さで引き抜く。但し、ダミーカードは未挿抜カードを使用する。 Pull the dummy card out of the lock position at the speed rate of 25±3 mm/minute. But, the dummy card use a unused card of insertion and withdrawal.		初回 First time	2.0 N MINIMUM {0.2 kgf MINIMUM}

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

miniSD SOCKET CONNECTOR
(NORMAL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-500972-001

FILE NAME

SEE SHEET 1 OF 14

SHEET

3 OF 14



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 (プッシュイン / プッシュアウト) Repeated Mate / Un-mate (Push in / Push out)	ダミーカードで、1時間に400~600回の速さで、挿入・抜去を10,000回繰り返す。尚、2000回毎にカードを交換する。 Insertion and extraction are repeated 10,000 cycles with the dummy card at the speed rate of 400 - 600 cycles/hour. Exchange the dummy card every 2000cycles.	接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM ダミーカードで測定 With the dummy card
			挿入力及び 抜去力 Insertion / Withdrawal Force	4-2-2項満足のこと (1000回毎に測定) Must meet 4-1-3 (Measure every 1000cycles)
			外観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	電流を通电し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAXIMUM
4-3-3	耐振動性 Vibration	ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通电状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に周波数10~55~10 Hz/分、全振幅1.52mmの振動を各2時間加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Mate dummy card and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test. Amplitude: 1.52 mm P-P Frequency: 10-55-10 Hz Shall be traversed in 1 minute. (MIL STD-202 Method 201)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
			瞬断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

miniSD SOCKET CONNECTOR
(NORMAL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-500972-001

FILE NAME

SEE SHEET 1 OF 14

SHEET

4 OF 14

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-4	耐衝撃性 Shock	<p>ダミーカードを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な6方向に490m/s² (50G) の衝撃を各3回加える。 (JIS C 60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213)</p> <p>Mate dummy card and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA current during the test. (Total of 18 Shocks) Test pulse: Half Sine Peak value: 490m/s²(50G) Duration: 11 ms (JIS C 60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
			瞬断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM
4-3-5	耐湿性 Humidity	<p>ダミーカードを嵌合させ、40±2°C、相対湿度90～95%の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置する。</p> <p>Mate dummy card and subject to the conditions of 40±2°C, relative humidity 90-95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
4-3-6	温湿度サイクル Moisture Resistance	<p>ダミーカードを嵌合させ、第7項に示す条件にて9サイクル行い、10サイクル目は段階6迄の試験を行う。但し、段階7aは初めの9サイクルのうち任意の5サイクルについて行う。試験後、室温に24時間放置する。 (MIL-STD-202 試験法 106)</p> <p>Mate dummy card and subject to the conditions specified on per. [7] for 9 cycles. The test specimens shall be exposed to STEP 7a during only 5 out of 9 cycles. A 10th cycles consisting of only step 1 through 6 is then performed, after which the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions of 24 hours. (MIL-STD-202 Method 106)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MINIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE: miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 14	
REV.	DESCRIPTION	
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

DOCUMENT NUMBER PS-500972-001	FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14	SHEET 5 OF 14
---	--------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-7	温度サイクル Temperature Cycling	<p>ダミーカードを嵌合させ、-55±3°Cに30分、+85±2°Cに30分、これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は3分以内とする。試験後、1~2時間室温に放置する。 (JIS C0025)</p> <p>Mate dummy card and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.</p> <p>1 cycle</p> <p>a) -55±3°C . . . 30 minutes b) +85±2°C . . . 30 minutes</p> <p>Transit time shall be within 3 minutes. (JIS C0025)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
4-3-8	耐熱性 Heat Resistance	<p>ダミーカードを嵌合させ、85±2°Cの雰囲気 に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に 放置する。 (JIS C 60068-2-2/MIL-STD-202 試験方法 108)</p> <p>Mate dummy card and exposed to 85±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C 60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
4-3-9	耐寒性 Cold Resistance	<p>ダミーカードを嵌合させ、-40±2°Cの雰囲気 に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に 放置する。 (JIS C 60068-2-1)</p> <p>Mate dummy card and exposed to -40±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditions at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C 60068-2-1)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE: miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 14	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-500972-001	FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14	SHEET 6 OF 14
---	--------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	ダミーカードを嵌合させ、40±2°C、 相対湿度75%にて10±5ppmの亜硫酸ガス中に 96時間放置する。 Mate dummy card and expose to 10±5 ppm SO ₂ gas, ambient temperature 40±2°C, relative humidity 75% for 96 hours.	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
4-3-11	塩水噴霧 Salt Spray	ダミーカードを嵌合させ、35±2°Cにて 5±1%重量比の塩水を48時間噴霧し、 試験後、常温で水洗いした後、室温で 乾燥させる。 (MIL-STD-1344) Mate dummy card and exposed to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1% Spray time: 48 hours Ambient temperature: 35±2°C (MIL-STD-1344)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	140 milliohms MAXIMUM
4-3-12	半田付け性 Solderability	端子先端より0.5mmの位置まで230±5°Cの 半田に3±0.5秒浸す。 Dip solder tails into the molten solder (held at 230±5°C) up to 0.5mm from the tip of tails for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の 90%以上 90% of immersed area must show no voids, Pinholes

REVISE ON PC ONLY		TITLE: miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 14	
REV.	DESCRIPTION	

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-500972-001	FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14	SHEET 7 OF 14
---	--------------------------------	------------------

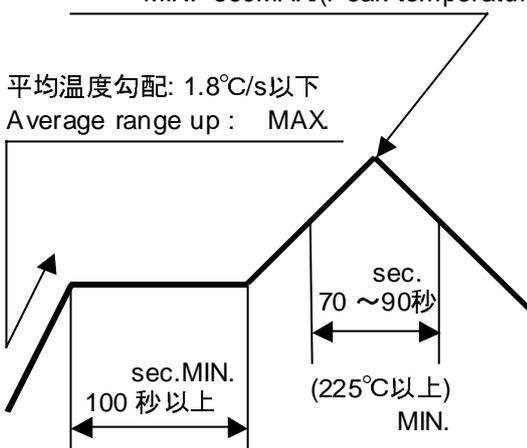


PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-3-13 半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	<p>リフロー半田付けの温度と時間は下記プロファイルで行う。 Performed to the following condition. 赤外線リフロー条件 <u>Infrared reflow condition</u></p> <p>260°C以上 3秒以下 (ピーク温度) MIN. secMAX.(Peak temperature)</p> <p>平均温度勾配: 1.8°C/s以下 Average range up : MAX</p>  <p>(予熱: 170~190°C) Pre-heat temperature</p> <p>sec. MIN. 100 秒以上</p> <p>sec. 70 ~90秒 (225°C以上) MIN.</p> <p>温度条件グラフ <u>TEMPERATURE CONDITION GRAPH</u> (基板表面温度) (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)</p>	<p>外 観 Appearance</p> <p>リフロー2回後、 端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage after 2 times of reflow</p>

REVISE ON PC ONLY		TITLE:
C	SEE SHEET 1 OF 14	miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-500972-001		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14	SHEET 8 OF 14
---	--	--------------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-14	手半田耐熱性 Resistance to Soldering Iron Heat	半田ごてを温度350±10℃で3±1秒間 ターミナルにあてる。但し、ターミナルに 異常な加圧のないこと。 Touch the terminal with the soldering iron (held at 350±10℃) for 3±1 seconds. However, without too much pressure to the terminal.	外 観 Appearance	ターミナルなどの 著しいガタがなく、 電気的性能・ 機械的性能に 異常なきこと Without deformation of product shape or excessive looseness of the terminals. Electrical and Mechanical characteristics shall be satisfied.

() : 参考規格

Reference Standard

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

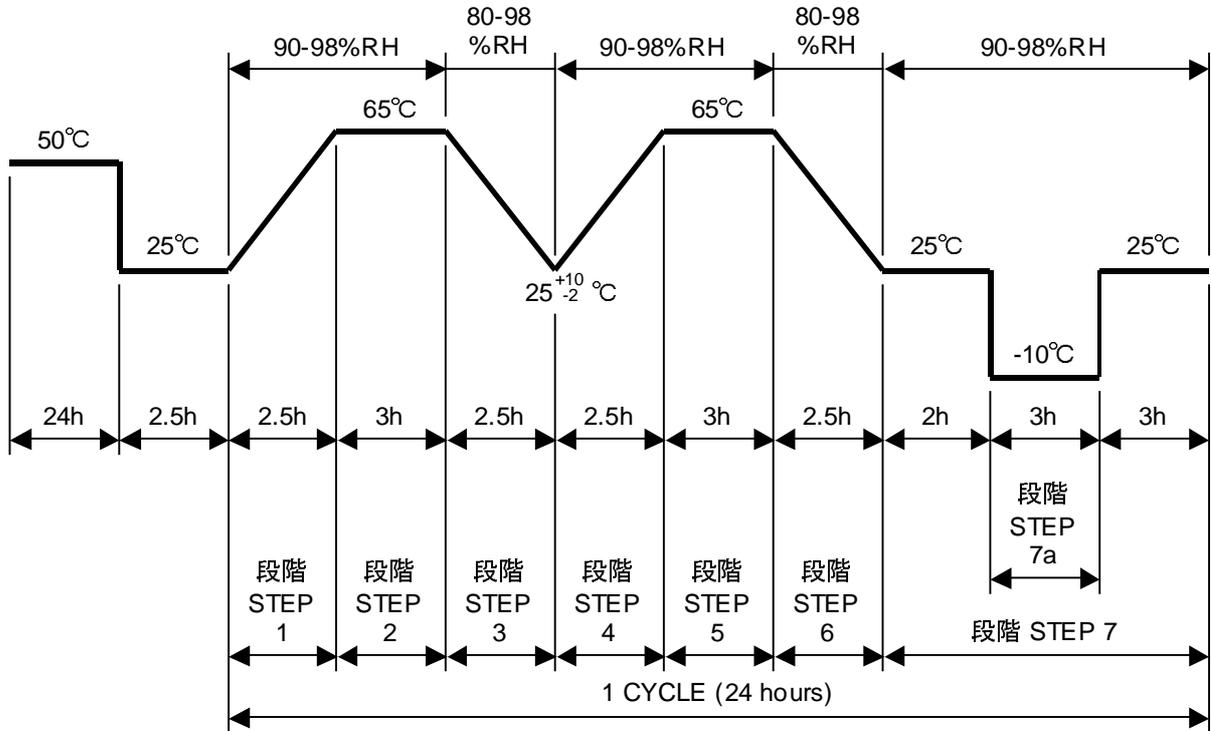
REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
C	SEE SHEET 1 OF 14	miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-500972-001		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14	SHEET 9 OF 14



【7. 耐湿性試験条件 MOISTURE RESISTANCE CONDITIONS】

MIL-STD-202 試験法 106

MIL-STD-202 Method 106



REVISE ON PC ONLY		TITLE: miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 14	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-500972-001		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14
		SHEET 11 OF 14



【8. 使用上の注意事項 APPLICATION NOTES】

8-1. カード抜け防止

Card omission prevention

本品にはカード抜け防止用の簡易ロックをカムスライダに設けていますが、カードを嵌合した状態で落下させたり、衝撃を加えるとカードが抜けてきます。従って、筐体にカード抜け防止用の蓋等を設置してください。その場合、カードロック状態でのカードと蓋等の隙間は0.3mm以下にしてください。

The card is dropped while having engaged or the impact is added and the card comes off to this item though a simple lock for the card omission prevention is installed in the cam slider.

Therefore, please set up the lid for the card omission prevention etc. in the enclosure.

In that case, please adjust the spaces such as cards and lids in the state of the card lock to 0.3 mm or less.

8-2. 半田付け後の洗浄

Washing after soldering

本品を半田付け後に洗浄をする場合は、半田付け部のみ部分的に洗浄を行ってください。ジャブ漬け等の洗浄をした場合は、カードの挿入、抜去が困難になる場合があります。

Please wash only the soldering part partially when washing after this item is soldered.

When a whole soaking etc. are washed, the insertion and extraction of the card might become difficult.

8-3. カードの挿入

Card insertion

miniSDソケットにはminiSDカード以外のものを挿入しないでください。また、miniSDカードも正規方向以外では挿入しないでください。

Please don't insert anything except miniSD card into this item. And please don't insert miniSD card in irregular directions.

8-4. 筐体への組み込み後、本品に直接大きな振動及び負荷等が加わらないように、取り付け基板に固定対策をしてください。

After assembling this item in the case, they shall be fastened to PCB where they are mounted so that they are free from direct excessive vibration and force.

8-5. 本品のコンタクト部には触れないで下さい。

Contacts of this item shall be kept from human touch.

8-6. カード飛び出し

Card ejection

本品はカード飛び出し制御機能を有していません。従って、カード排出時、カードを押している指又は治具等をカードから急に離すと、本品からカードが飛び出しますので、十分ご理解の上ご使用下さい。

Please use caution when ejecting the card from the connector. The connector doesn't have the card ejection control function. When pushing the card, the spring force could cause the card to pop out and project from the connector if finger or slip pushing the card is removed improperly.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
C	SEE SHEET 1 OF 14	miniSD SOCKET CONNECTOR (NORMAL TYPE) 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-500972-001		FILE NAME SEE SHEET 1 OF 14	SHEET 12 OF 14
EN-37-1(019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

8-7. 基板実装後に基板を直接積み重ねないように、注意して下さい。

After mounting of connectors, please care of not pile up on the PCB which mounted connectors directly.

8-8. FPCへの実装時及び実使用時の注意点

The notes when FPC is mounted and used really

半田付け部の未半田、本品の反り防止のために実装時及び実使用時はFPCの下または周辺に補強版を入れ、コネクタを固定して下さい。製品性能が出ない場合があります。

For unsolder in soldering part and curvature prevention of a connector, the reinforcement version puts around the bottom of FPC at the time of mounting and real use, and it fixes a connector.

The product performance might not go out.

8-9. カード無理抜き

Unreasonableness omission of card

カードがロックされた状態で、カードを無理に引き抜かないようにして下さい。製品内部を破損する恐れがあります。

Where a card is lock within a connector, please do not draw out a card by force. There is a possibility of damaging a product core.

8-10. カード嵌合状態、あるいは、カード無理抜き等によるカムスライダをロックした状態にて、リフロー等、加熱はしないで下さい。加熱によるストレスにより、カードロック機構は破損する恐れがあります。

Please do not apply heat while the card is locked inside of the product or cam slider is still locked position by forced withdrawal of card. The heat stress may cause to the damage card lock mechanism.

8-11. 半田付け部の未半田は、ターミナル脱落、ターミナル間ショート、ターミナル座屈、また、コネクタの基板からの外れが懸念されます。従って、全ての半田付け部(計17ヶ所)に半田付けを行って下さい。

As for the unsolder of the solder part are anxious about terminal omission, short-circuit between terminals, terminal bend, and the blank from the PCB of a connector. Therefore, please solder to all solder parts (total of 17 places).

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

miniSD SOCKET CONNECTOR
(NORMAL TYPE)

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

PS-500972-001

FILE NAME

SEE SHEET 1 OF 14

SHEET

13 OF 14

EN-37-1(019)

